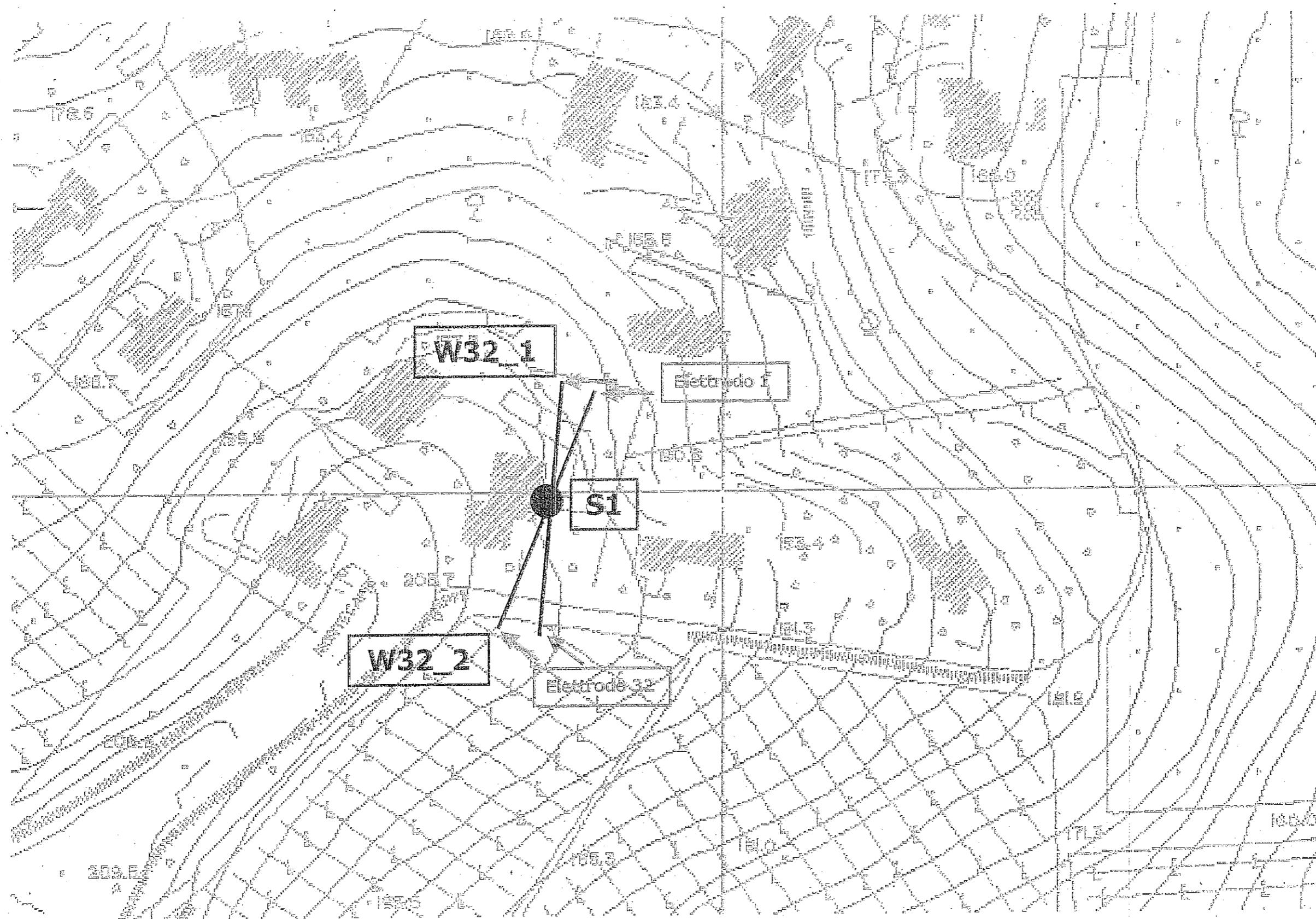


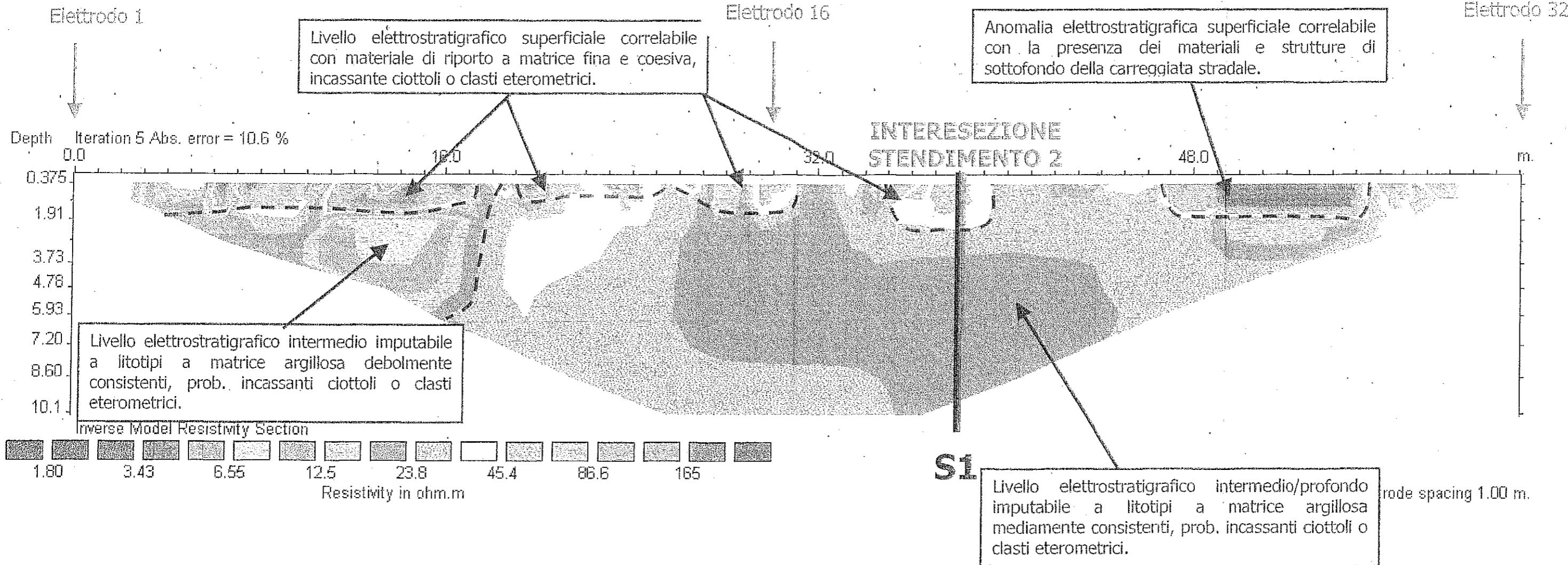
All. B Tav. B1

Estratto Planimetrico – Scala 1:1000



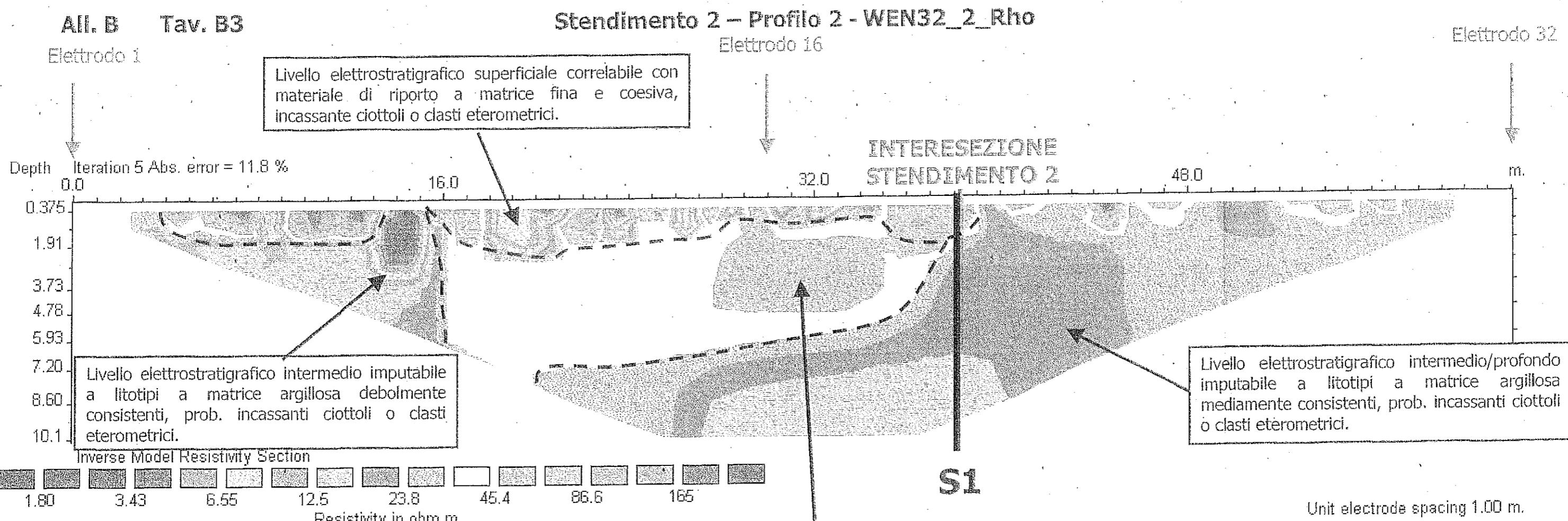
All. B Tav. B2

Stendimento 1 – Profilo 1 - WEN32_1_Rho

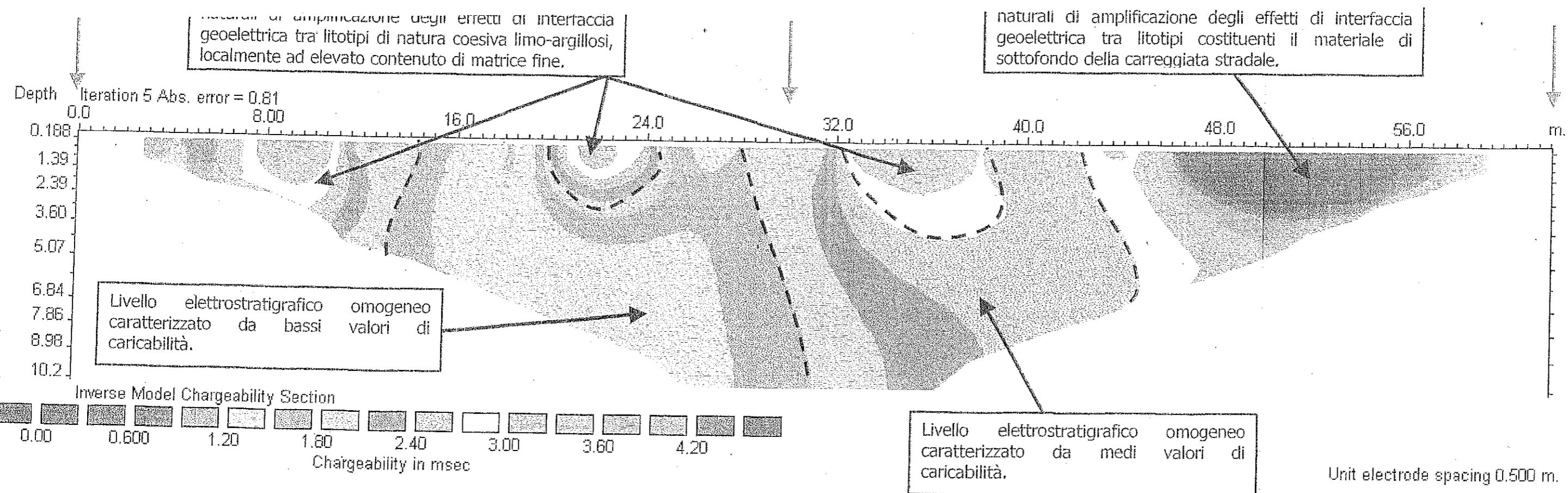


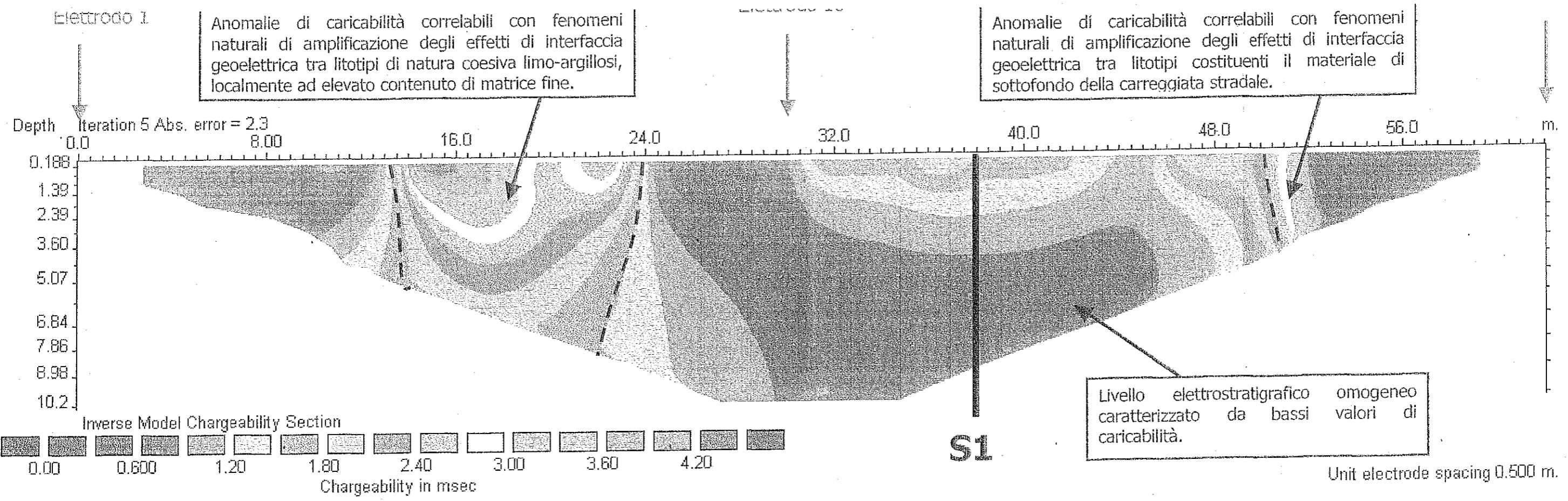
Disegno non in scala – Scala orizzontale e verticale 1:1

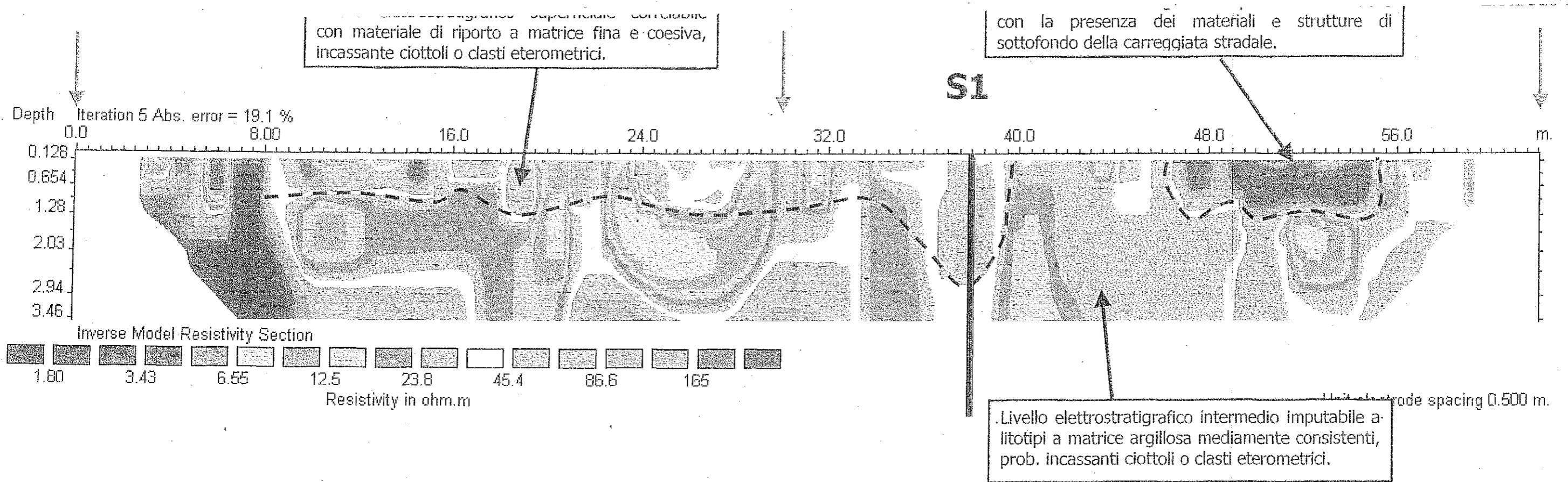
All B Tav. B3



Disegno non in scala – Scala orizzontale e verticale 1:1







All. B Tav. B7

Stendimento 2 – Profilo 6 DIP32_2_Rho

Livello elettrostratigrafico superficiale correlabile con materiale di riporto a matrice fina e coesiva, incassante ciottoli o clasti eterometrici.

Elettrodo 32

Elettrodo 1

Livello elettrostratigrafico superficiale correlabile con materiale di riporto a matrice fina e coesiva, incassante ciottoli o clasti eterometrici.

Elettrodo 16

Livello elettrostratigrafico intermedio imputabile a litotipi a matrice argillosa ben consistente, prob. incassante ciottoli o clasti eterometrici.

Depth Iteration 5 Abs. error = 20.6 %

0.0 8.00 16.0 24.0

0.085 0.633 1.35 1.96 2.69 3.68

32.0

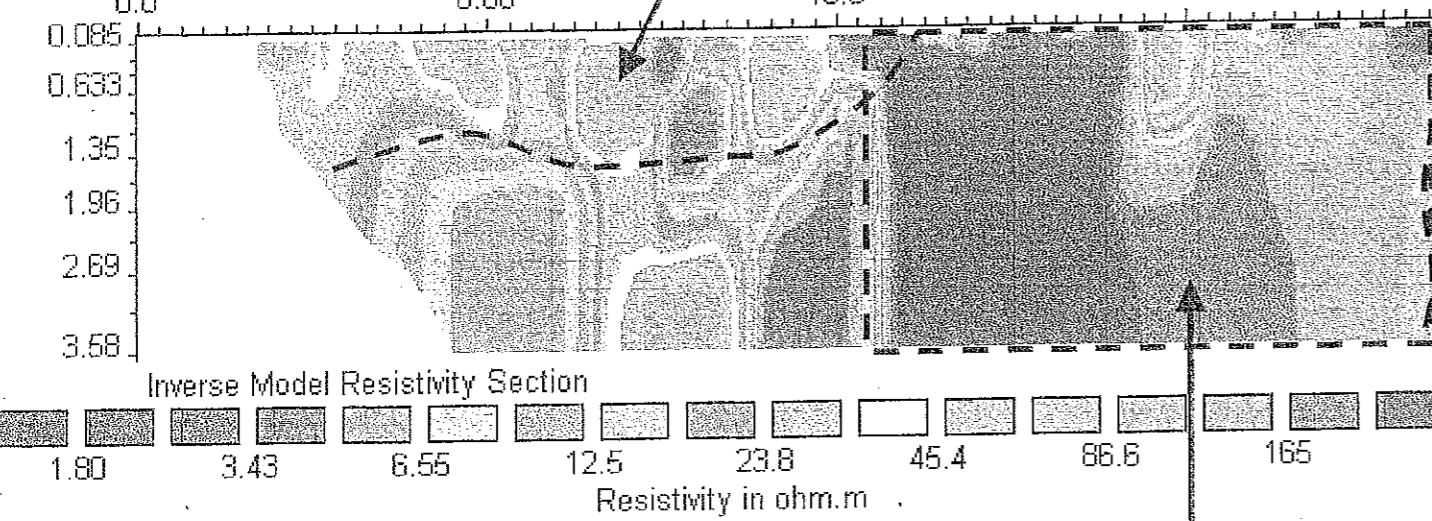
S1

40.0

48.0

56.0

m.



Unit electrode spacing 0.500 m.

Anomalia resistiva imputabile agli effetti di interfaccia, prossimità e contatto di corpi ad elevato contrasto di resistività (prob. manufatto sepolto)

Livello elettrostratigrafico intermedio imputabile a litotipi a matrice argillosa mediamente consistenti, prob. incassanti ciottoli o clasti eterometrici.

Disegno non in scala – Scala orizzontale e verticale 1:2